

深圳市亿道信息股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上交流）
参与单位名称	天风证券
时间	2026年5月25日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书 乔敏洋女士 IR 谢蝶
交流内容及具体 问答记录	<p>1、请讲一下公司未来的研发方向？</p> <p>答：公司秉承成为“全球最优秀的AI产品解决方案提供商”的战略愿景，坚定推进“AI+”战略深化，聚焦“AI+应用”与“AI+终端”的产业布局，持续推动人工智能技术与产品设计、场景应用深度融合，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务。</p> <p>在人工智能方向，注重AI原生硬件开发创新解决方案，拓展创新应用场景；在空间计算上，力求突破物理世界与数字世界的空间壁垒，实现数字与人的互动；在人机交互方面，基于用户研究设计自然高效交互方式，采用多模态交互技术提升人机沟通效率。最终将这些技术应用用于个人、家庭和企业计算范式中，在各领域为用户提供个性化、智能化服务，构建智能家庭生态，助力企业数字化转型，从而持续提升自身核心竞争力并为行业发展贡献力量。</p> <p>2、介绍一下公司未来规划？</p> <p>答：All in AI，是公司的战略方向。公司秉持“让前沿科技更平易近人”的使命，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务。</p>

	<p>基于 AI 技术加速发展的趋势，深化 AI 在 AR、超算、工控等领域的应用落地，实现了向“场景智算体系构建者”的转型。</p> <p>公司持续升级生产制造能力，2025 年公司与华封科技合作发起亿封智芯先进封装项目，提前布局下一代技术路线，在系统级制造能力维度完成前瞻性布局。</p> <p>公司持续加大前沿技术领域的研发投入，以长期科技投入构建企业核心竞争力，亿道数字（研究院）自主研发的端侧推理框架（AESOF）已经应用于公司的 NAS、AI PC、一体机等产品中，有效解决跨平台跨系统端侧模型适配及推理效率问题，加速产品研发并提升产品性能。</p> <p>在 AI 应用端，公司与粤港澳大湾区数字经济研究院（简称“IDEA 研究院”）联手，共同建设 IDEA 亿道边缘计算人工智能实验室，聚焦 AI 模型在边缘计算领域的应用与发展，推动技术成果转化。</p> <p>公司持续深挖现有客户需求，助力国产品牌出海，积极导入国内外大客户，2025 年已逐步显现成效，未来将持续促进公司生产经营规模扩大。</p> <p>公司将依托在硬件制造领域的深厚积淀、对端侧部署复杂性的深刻理解，以及开放共建的生态理念，携手芯片巨头、存储伙伴、算法厂商、ISV（独立软件开发商）及开发者社区等合作伙伴，共同推进 AI 技术的普惠化进程。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</p>	<p>无</p>